

## 铜箔基板用树脂固化剂

固化剂规格	粘度 (mPa.s/25°C)	固形份 (wt%)	羟基当量 (g/eq)	特性
GERH321K65	3000~7000	64.0~66.0	108	PN 固化剂，适用无铅制程
GERH326K65	3500~7000	64.0~66.0	120	PN 固化剂，适用无铅制程
GERH832K65	1800~3800	64.0~66.0	120	PN 固化剂，适用无铅制程
GERH983K65	1500~3000	64.0~66.0	120	PN 固化剂，适用无铅制程